



EV Group schließt Bau der neuen Fertigung V am Firmenhauptsitz in St. Florian am Inn (Oberösterreich) zur Erweiterung der Produktionskapazität ab

Expansion des Unternehmens wird durch Marktwachstum im Bereich 3D- / Heterogene Integration und starke Nachfrage nach Hybrid-Bonding- und anderen führenden Prozesslösungen von EVG angetrieben

ST. FLORIAN, Österreich, 28. November 2023—EV Group (EVG), ein führender Entwickler und Hersteller von Anlagen für Waferbonding- und Lithographieanwendungen in der Halbleiterindustrie, Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie, gab heute den Abschluss der Bauarbeiten für die nächste Erweiterungsphase der Unternehmenszentrale bekannt. Die neue Fertigung V, die bereits eröffnet wurde und in der zentrale Komponenten der EVG-Anlagen hergestellt werden, bedeutet eine deutliche Vergrößerung der Produktions- und Lagerfläche. Die Eröffnung der Fertigung V ist die jüngste in einer Reihe von Expansionsphasen und Investitionen, die durch die anhaltend starke Nachfrage nach den Hybrid Bonding- und anderen Prozesslösungen von EVG sowie Prozessentwicklungsdienstleistungen zur Unterstützung des schnell wachsenden Marktes für Advanced Packaging und 3D- bzw. Heterogene Integration vorangetrieben werden.

Die hochmoderne Fertigung V von EVG erweitert die Produktionsfläche um mehr als 1.200 m² auf insgesamt über 8.100 m², darüber hinaus wächst die Lagerfläche um mehr als 1.200 m². Über der Produktionshalle entstanden zudem zwei neue Etagen mit Büroflächen. Parallel dazu wurde die bestehende Fertigung II umgebaut, um neun neue Testräume für die Endmontage und den Test der Präzisionsmaschinen von EVG sowie für deren technische Abnahme durch die Kunden von EVG bereitzustellen. Dies führte zu einer Vergrößerung der Testraumfläche am EVG Headquarter um 30 Prozent auf insgesamt fast 2.800 m².

Die Eröffnung der Fertigung V folgt direkt auf die vorherige Expansionsphase des Unternehmens, als mit der Ende letzten Jahres fertiggestellten Fertigung IV bereits fast 1800 m² Produktionsfläche und zusätzliche Lagerflächen hinzukamen. Seit Beginn dieser beiden, jüngsten Wachstumsphasen hat EVG seine Produktionskapazität um mehr als 60 Prozent erweitert. Die Fertigung VI, die nächste Ausbaustufe bei EVG mit zusätzlichen 1.400 m² Produktions- und ebenso viel Lagerfläche, ist bereits im Bau und soll in der zweiten Jahreshälfte 2024 fertiggestellt werden.

Dr. Werner Thallner, Executive Operations and Financial Director und Mitglied des Executive Boards bei EV Group, erklärt: „Neue Anwendungen, die die Halbleiterindustrie vorantreiben, wie künstliche Intelligenz, Hochleistungs-Computing und autonomes Fahren, erfordern massive Innovationen im Bereich Advanced Packaging. Dabei sind Fusions- und Hybrid-Bonding als zentrale Technologien für die 3D- und Heterogene Integration zu den neuen Skalierungsmechanismen für die Halbleiterproduktion geworden. EVG ist bei der Entwicklung von Fusions- und Hybridbonding- und anderen Prozesslösungen, die unsere Kunden zur Unterstützung ihrer aktuellen und zukünftigen Kapazitätssteigerungen sowie ihrer langfristigen Produkt-Roadmaps benötigen, führend. Die stetig wachsende Nachfrage nach unseren Produkten im Laufe der Jahre hat uns dazu veranlasst, große Investitionen in die Erweiterung unserer Produktions- und Reinraumkapazitäten zu tätigen, um den steigenden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. Wir gehen fest davon aus, dass sich dieses Nachfragewachstum in den kommenden Jahren fortsetzen wird.“



EVG Lösungen für die Heterogene Integration

Die Waferbonder, Lithographie- und Messtechniklösungen von EVG ermöglichen die Entwicklung und Hochvolumenfertigung von Technologie-Innovationen im Bereich Advanced Packaging – einschließlich rückseitig belichteter CMOS-Bildsensoren und anderer, gestapelter 3D-ICs – sowie im Bereich MEMS und Verbindungshalbleiter. Jüngste Durchbrüche im Hybrid-Bonding zur Erfüllung der Anforderungen an die 3D-Integration von Devices, beim Wafer-Bond-Alignment für zukünftige Anforderungen beim 3D-IC-Packaging, bei der IR-Laser-Release-Technologie zum Ersatz von Glassubstraten beim Advanced Packaging und zur 3D-Stapelung dünnster Schichten, der maskenlosen Belichtung für das Fan-Out Wafer-Level Packaging (FOWLP) sowie bei NIL-Anwendungen und der Resist-Verarbeitung zur Herstellung von Wafer-Level-Optiken (WLO) sind nur einige Beispiele für die Technologieführerschaft von EVG in den Bereichen Heterogene Integration und Wafer-Level-Packaging.

Über EV Group (EVG)

Die EV Group (EVG) ist anerkannter Technologie- und Marktführer für Präzisionsanlagen und Prozesslösungen zur Waferbearbeitung in der Halbleiterindustrie, Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie. Zu den Kernprodukten gehören Waferbonder, Systeme zur Dünnwafer-Bearbeitung, Lithographie- und Nanoprägelithographie-Systeme sowie Fotoresist-Belacker, Reinigungs- und Metrologiesysteme. Das 1980 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in St. Florian am Inn (Österreich) beschäftigt mehr als 1300 Mitarbeiter*innen und betreut mit eigenen Niederlassungen in USA, Japan, Korea, China und Taiwan sowie Repräsentanzen namhafte Produktionskunden und R&D-Partner in aller Welt. Mehr Informationen unter www.EVGroup.com.

Pressekontakte:

Clemens Schütte
Director, Marketing and Communications
EV Group
Tel: +43 7712 5311 0
E-mail: Marketing@EVGroup.com

David Moreno
Principal
Open Sky Communications
Tel: +1.415.519.3915
E-mail: dmoreno@openskypr.com

###